



Plasma Ion Assist Co.,Ltd

高速成膜PIAD装置

	PBIID方式	PIAD方式
プラズマによる表面改質方式の違い	<p>高周波電源 負パルスイオン源</p> <p>重畳式イオン源</p>	<p>正負パルスイオン源</p> <p>13.56kHz 外部RFイオン源</p>
特徴	<p>形状に沿ったプラズマを生成するため、基材に13.56MHz高周波を架け均一化。負パルスのみで、正イオンを引きつけイオン注入。微細部分への処理不可。</p>	<p>微細部分やパイプ内部への処理を容易にするため、基材に正負パルス印加しプラズマを均一化。さらに外部RFイオン源でプラズマ密度をアップして、高速成膜を可能。</p>